

Japan Pavilion @ IPB 2026 出展募集

2026年7月22日～24日に上海において粉体工業展 IPB 2026 が開催されます。

当協会では、Japan Pavilion を設置し、共同出展の募集をいたします。是非ご出展を検討ください。

【展示会概要】

展示会名：IPB 2026 International processing Trade Fair for Powder, Bulk Solids and Fluids

会 期：2026年7月22日（水）～24日（金）3日間

会 場：Shanghai World Expo Exhibition & Convention Centre (SWEECC)

主 催：中国顆粒学会、ニュルンベルクメッセチャイナ

協賛団体：一般社団法人日本粉体工業技術協会 他

【共同出展募集要項】

出 展 料：会員 165,000 円（税込）、一般 198,000 円（税込）

出展料に含まれるもの：

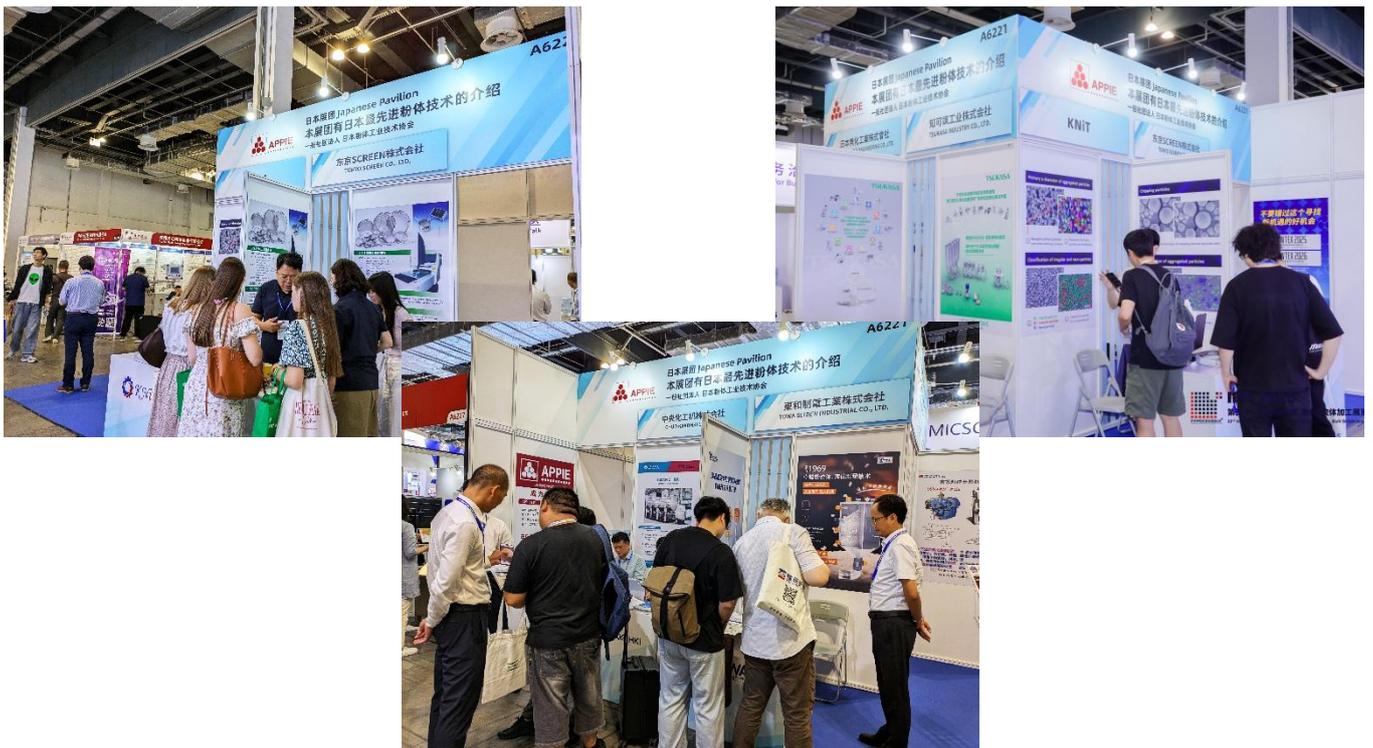
出展スペース、共同装飾デザイン・工事費用、A0サイズのポスター印刷 1-2 枚、
展示パネル、展示台（幅 1m×奥行 0.5m×高さ 0.75m）、照明、椅子、
共同使用スペース、展示会主催者との各種調整

募 集 数：12 社（先着順に受け付けます。）

申 込 方 法：申込書にご記入いただき、下記申込先までメールにてお申込みください。

申 込 締 切：2026年6月12日（金）

申 込 先：協会・東京事務所 大久保 E-mail: okubo@appie.or.jp Tel: 03-3815-3955



IPB 2025 での Japan Pavilion

Japan Pavilion @ IPB 2026 出展申込書

下記必要事項をご記入の上、メールにて申込書を送付ください。

お申込み後 3 日以内に確認のご連絡をいたします。連絡がない場合は、恐れ入りますが、お電話ください。

送付先：(一社) 日本粉体工業技術協会 東京事務所 大久保

Email: okubo@appie.or.jp Tel: 03-3815-3955

申込日 2026 年 月 日

社名	
氏名	
所属部署/役職	
会社住所	〒
電話番号	
Email	